

※本リリースは鉄鋼研究会へ配布しております。

2024年9月10日

TANAKA ホールディングス株式会社

田中貴金属グループ、半導体産業に特化した 九州初の専門展「[九州]半導体産業展」に出展

～通信・車載関連の電子部品材料と
半導体向け接合材料やめっきプロセスを展示～

貴金属を中心とした事業を展開する田中貴金属グループ（田中貴金属工業株式会社、田中電子工業株式会社、EEJA 株式会社）は、2024年9月25日（水）・9月26日（木）に、福岡県で開催される九州初の半導体専門展「[\[九州\]半導体産業展](#)」に出展することを発表します。

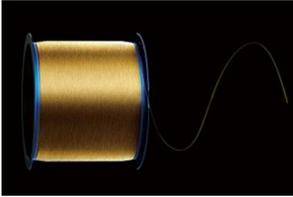
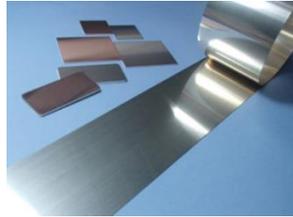
本展示会では、ボンディングワイヤ、Ag 接着剤、活性金属ろう材/銅複合材、半導体向け各種めっきプロセスなどの半導体パッケージング向け製品をパネル展示いたします。

昨今、九州では半導体産業が盛り上がりを見せており、新たな雇用や経済効果の創出が期待されています。田中貴金属グループは、市場規模の拡大に伴って求められている生産性の向上とコスト削減に寄与する様々な半導体パッケージング向け製品を提供しています。その一部を、日本の半導体産業の成長拠点となる九州で初開催される本展示会で紹介します。

田中貴金属グループは、長年にわたって半導体パッケージ材料で実績を積んできたリーディングカンパニーとして、ますますの研究開発を進め、日本の半導体産業の発展と技術革新に貢献してまいります。

【[九州]半導体産業展 出展概要】

- 展示会名：[九州]半導体産業展
- 会期：2024年9月25日（水）・9月26日（木） 10:00~17:00
- 会場：マリンメッセ福岡 B館
- 公式サイト：<https://k-semi.jp/>
- 出展社：田中電子工業株式会社、田中貴金属工業株式会社、EEJA 株式会社
- ブース番号：1-12
- 主なパネル展示内容：ボンディングワイヤ、Ag 接着剤、活性金属ろう材/銅複合材、半導体向け各種めっきプロセス

製品名	製品写真	概要
ボンディングワイヤ		半導体チップの電極と、リードフレームの電極を電氣的に接続するための金属線です。髪の毛の1/5程度の細いワイヤ形状のものから、太さ数ミリのリボン形状のものまで、さまざまな種類の製品があります。材質は金、銀、銅(パラジウム被覆銅)、アルミニウムなどがあり、用途に応じて使い分けられます。我々の身近なスマートフォン、PC、自動車などの民生品だけでなく、産業用の機械など至る所で使用されています。
Ag 接着剤		半導体チップとリードフレーム等の基板を接合するダイボンド用導電性接着剤です。パワーデバイス用途のSi、次世代半導体SiC、GaNのチップに対応します。高熱伝導と高信頼性の両立が可能なハイブリッド接合タイプと、200W/m・Kを超える高熱伝導シンタリングタイプをラインナップに揃えています。高信頼性が求められる車載向けや高温 Pb はんだペースト代替などに使用されます。
活性金属ろう材/銅複合材		銅材の片側に活性金属ろう材を複合化(クラッド)した製品です。セラミックス(酸化物、窒化物、炭化物)や炭素素材など任意の材料にダイレクトに接合することができるため、パワーデバイス用セラミックス回路基板や次世代ヒートシンクへの適用が期待されます。
半導体向け各種めっきプロセス		半導体実装に適した各種バンプめっきプロセス、裏面ダイボンド用めっきプロセス、ビアフィリングめっきプロセスを紹介します。特にシアン化合物を使用しないノンシアン Au めっきプロセスは、実装条件により異なる硬度仕様に適応した各種プロセスを準備しています。また高信頼性、高放熱性に優れたビアフィリング向けの Au めっきプロセスは、フィリング用添加剤の独自開発により実現したプロセスです。

【田中貴金属工業株式会社】

本社所在地：東京都中央区日本橋茅場町 2-6-6

創 業：1885 年 設 立：1918 年

代 表 者：代表取締役社長執行役員 田中 浩一朗

資 本 金：5 億円 売 上 高：2,172 億 458 万 1,000 円 (2023 年度)

従 業 員 数：2,498 名 (海外子会社含む) (2023 年 12 月 31 日)

事 業 内 容：貴金属地金(白金、金、銀、その他)および各種産業用貴金属製品の製造・販売および輸出入

【田中電子工業株式会社】

本社所在地：佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 2303-15

設 立：1961 年

代 表 者：代表取締役社長執行役員 山本 俊哉

資 本 金：18 億 8,000 万円 売 上 高：215 億 9,131 万 8,000 円 (2023 年度)

従 業 員 数：859 名 (海外子会社含む) (2023 年 12 月 31 日)

事 業 内 容：高純度各種ボンディングワイヤの製造

【EEJA 株式会社】

本社所在地：東京都中央区日本橋茅場町 2-6-6

設立：1965 年

代表者：代表取締役社長執行役員 庄司 亨

資本金：1 億円 売上高：216 億 433 万 3,000 円（2023 年度）

従業員数：130 名（海外拠点含む）（2023 年 12 月 31 日）

事業内容：貴金属・卑金属めっき液、添加剤および表面処理関連薬品の開発、製造、販売、輸出

平塚事業所：神奈川県平塚市新町 5-50

会社情報

■田中貴金属グループについて

田中貴金属グループは 1885 年（明治 18 年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年に渡って、産業用貴金属製品の製造・販売ならびに、資産用や宝飾品としての貴金属商品を提供しています。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術開発において連携・協力し、製品とサービスを提供しています。

2023 年度（2023 年 12 月期）の連結売上高は 6,111 億円、5,355 人の従業員を擁しています。

■産業事業グローバルウェブサイト

<https://tanaka-preciousmetals.com>

■製品問い合わせフォーム

田中貴金属工業株式会社

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/inquiries-on-industrial-products/>

■報道機関お問い合わせ先

- ・ T A N A K A ホールディングス株式会社

サステナビリティ・広報本部 広報・広告部

加藤、小柴、島野

TEL：03-6311-5590 E-mail：tanaka-pr@ml.tanaka.co.jp

- ・ 田中貴金属グループ 広報事務局（共同ピーアール株式会社）

担当：安田、庄司

TEL：03-6260-4854 FAX：03-6700-5620 E-mail：thdpr@kyodo-pr.co.jp